

Electroformed Bond Hub Blades

ZHDG SERIES

高品位な基板切断を実現する電鍍ハブブレード

ハンドリングが容易な基板切断用ハブブレード

豊富な粒径・集中度ラインアップで、 高品位な加工を実現

各種基板の切断用に開発されたZHDGシリーズは、半導体ウェーハ用のハブブレードよりも大きな粒径を採用、集中度ラインアップも豊富で様々なお客様のご要求に応えるハブブレードです。

- アルミ基台付きのため、ハブレスタイプの基板切断用ブレードと比較し作業性が向上
- 豊富な粒径・集中度ラインアップから選択が可能
- 低集中度を選択することで樹脂・金属バリを低減



■ZHDGシリーズの位置付け



加工対象

チップLED基板、各種半導体パッケージ、他

仕様

厚さ

角度

θ

ZHDG

SD

700

N1

60

R

150

×

60

E

SS

砥粒種類

粒径

ボンド

集中度

刃先出し量

先端形状※1

スリット※2

SD

360

N1

30

C 1.05 - 1.20

K 2.25 - 2.40

E

400

60

D 1.20 - 1.35

L 2.40 - 2.55

N

500

90

E 1.35 - 1.50

M 2.55 - 2.70

O

600

120

F 1.50 - 1.65

N 2.70 - 2.85

P

700

G 1.65 - 1.80

O 2.85 - 3.00

Q

800

H 1.80 - 1.95

P 3.00 - 3.15

R

1000

I 1.95 - 2.10

Q 3.15 - 3.30

J 2.10 - 2.25

R 3.30 - 3.45

E

N

S

特殊仕様

S1

割数

4

S2

割数

8

S3

割数

16

SS

特殊仕様

※1

※2

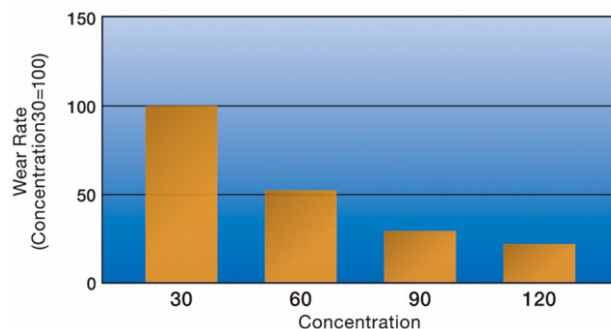
※1 ブレード厚さ0.1 mm以上より対応可能です。

※2 スリット幅は全て0.5 mmです (SSは除く)。スリット深さは全て1.0 mmです (SSは除く)。

(mm)

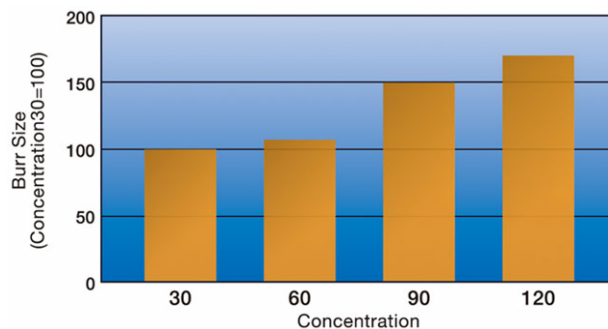
実験データ

■集中度別消耗量比較



Workpiece : Dresser board
Depth : 0.5 mm (Half cut)
Feed speed : 30 mm/s
Spindle revolution : 30,000 min⁻¹
Grit size : #700

■集中度別加工品質(金属バリ)



Workpiece : Resin substrate with electrodes
Depth : 1.5 mm (Full cut)
Feed speed : 50 mm/s
Spindle revolution : 30,000 min⁻¹
Grit size : #700

弊社製品は全て製造物賠償責任保険がついております。

ご注文に際して

タイプ名・外径・厚さ・内径及び数量をお知らせください。また、新規ご注文の場合は弊社営業担当員が選定のお手伝いをさせていただきます。研削材料・寸法・形状・使用機械(装置)その他諸条件を詳しくお知らせください。
・仕様は改良のため、お断りなく変更させていただくことがありますので、ご確認の上ご発注くださいますようお願い申し上げます。



安全にご使用いただくために

ブレード、ホイール(以下、精密加工ツール)の破損による事故やケガを未然に防止するために以下の事項を必ずお守りください。

- 安全カバー(ノズルケース、カバー)を使用してください。
- 制限回転数表示のある精密加工ツールは指定の回転数を超えて使用しないでください。
- 精密加工ツールを装着する際は機械(装置)の取扱説明書に従って正しく装着してください。
- 精密加工ツールを落としたり、ぶつけたりしないでください。
- 使用する際には必ず毎回精密加工ツールを確認して、欠けやその他破損がある場合は使用を中止してください。
- ご使用の機械(装置)の取扱説明書をよく読んでからご使用ください。
- 改造された機械(装置)は使用しないでください。
- 機械(装置)指定サイズに合わない精密加工ツールは使用しないでください。
- 切断・研削以外の目的には使用しないでください。
- 湿式切断の精密加工ツールは冷却液をご使用ください。